

半導体CRグレード投入

積水フーラー ガス漏出極少

抗菌シーリング材

積水化学工業（株）B.フーラーの合弁会社である積水フーラー（東京都港区）は強みを持つ変成シリコン系シーリング材で、半導体工場向けの新製品を2024年9月中に発売する。抗菌シーリング材「抗菌GOOD（コーキング）シリーズ」から、半導体工場のクリーンルーム（CR）に適したグレードを投入する。高い抗菌性能に加え、電子部品に付着して悪影響を及ぼすガスの漏出（アウトガス）が極めて少ないのが特徴だ。将来的に半導体工場のクリーンルーム向けシーリング材で30%以上のシェア獲得を目標として提案を本格化させる。

シェア30%超めざす

半導体工場のクリーンルームには高い清浄度が求められ、空気中の微粒子、湿度、温度、圧力、静電気などの環境条件を厳格に管理する必要がある。シーリング材に対しても同様で、電子部品への悪影響が懸念される。物質の漏出を極力減らすことが求められる。とくに現在主流のシリコン系の組成で、ほかのアウトガス成分の漏出も極めて少ない。同社が実施した試験では低分子環状シロキサンだけでなく、フタル酸系可塑剤やアジペート系可塑剤といったアウトガス成分も検出限界を下回った。



クリーンルーム用の抗菌GOOD

施工性にも優れる製品だ。液だれがしにくい上に軽く押し出すことができるため、作業者の負担が軽減できる。シーリング材は目地が動くため耐久性も重要な要素となるが、その面でも従来製品を上回る性能を示す。現場の声が開発のきっかけとなった。顧客や施工業者とのやり取りを重ね、ニースの把握に力を注いだ。現在はフレ販売という形式で顧客への提案

の半導体工場向けに提案を行う。半導体工場のクリーンルーム向けではシリコン系シーリング材が主流だが、将来的には同製品で市場シェアを30%以上まで拡大することを目標とする。

スコット・パーギンディール社長は「半導体工場では見えない部分に気を配る必要がある。顧客ニーズに合致した高機能な製品だ」と語り、シェア拡大に向けた自信を見せた。積水化学グループの販路を活用し、海外販売を行うことも視野に入れているという。

経済安全保障の観点から日本政府は半導体産業を国家戦略の柱と位置づけ、各種支援策を打ち出している。それを受けて国内で半導体工場の新設や既存工場の更新といった動きが盛んだ。

積水フーラーは、主力

供を行っており、評価は上々だという。大村正徳住宅・建材事業本部長は「顧客からのフィードバックを受けながら調整を重ねた。現場に喜んでもらえる製品にすることができた」と語る。

9月中にも本格販売を開始する。ガン型の塗布機で塗布できるカートリッジタイプ、ソーセージ型のフィルムに入ったタイプの2種類から選ぶことができる。当面は国内

である変成シリコン系を滋賀工場（滋賀県甲賀市）で製造している。同工場では変成シリコン系の生産能力の増強を実施済みで、24年8月に稼働を開始した。増強幅、投資額は非公開としているが、建築関連用途への販売が好調に推移していることが投資の主な理由だ。幅広い製品ラインアップを武器にさらなる需要の取り込みを図る。